

TIF™700M是一种填充发热器件和散热片或金属底座二者之间的空气间隙。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。其优异的效能使热量从发热器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上，从而提高发热电子组件的效率和使用寿命。

TIF™ 700M系列特性表

颜色	灰色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	*****
厚度范围	0.020"-0.200"	ASTM D374
硬度	55 Shore 00	ASTM 2240
比重	3.25 g/cc	ASTM D297
使用温度范围	-40~200°C	*****
击穿电压(T= 1mm 以上)	>5500 VAC	ASTM D149
介电常数@1MHz	4.2 MHz	ASTM D150
体积电阻率	5.2X10 <sup>13</sup> Ohm-cm	ASTM D257
热传导率	6.0 W/mK	ASTM D5470
	6.0 W/mK	GB/T 32064
总质量损失 (TML)	0.30%	ASTM E595
防火等级	94 V0	GB/T 2408

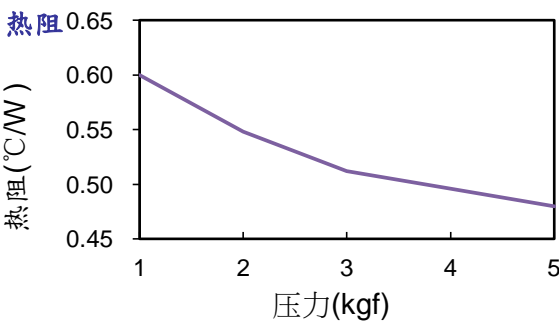
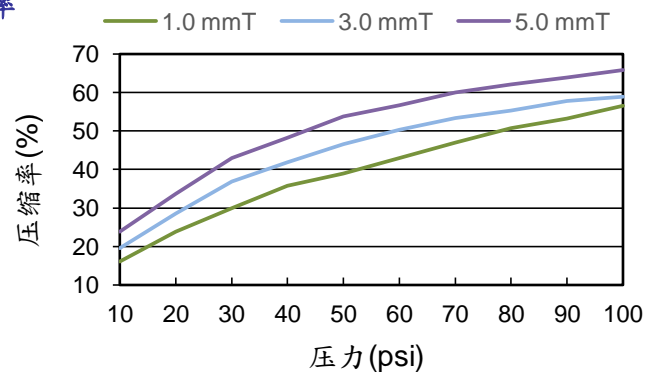
**特性**

- 》良好的热传导率: 6.0 W/mK
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性, 柔软兼有弹性, 适合于低压力应用环境
- 》可提供多种厚度选择

**应用**

- 》散热器底部或框架
- 》机顶盒
- 》电源与车用蓄电池
- 》充电桩
- 》LED电视、灯具
- 》RDRAM内存模块
- 》微型热管散热器

**压缩率**



**产品规格**

**标准厚度:**

0.020"(0.5mm)~0.200" (5.0mm)

如需不同厚度请与本公司联系。

**标准尺寸:**

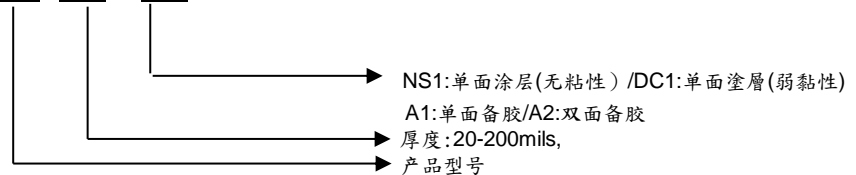
8"x16" (203mmx406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。

欲了解更多导热材料的产品信息

**产品型号说明**

TIF7 80M - NS1



**导热材料**

**发热材料**

**导热工程塑料**

**发泡硅胶**

**模切制品**

**加拿大:**

Tel: +001-604-2998559  
E-mail: sales@thermazig.com

**中国:**

Tel: +86-769-38801208  
E-mail: frances@ziitek.com.tw

**台湾:**

Tel: +886-2-22771007  
E-mail: frances@ziitek.com.tw

导热介面材料  
应用技术下载

